

证券代码：688233

证券简称：神工股份

## 锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-006

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位及人员</b>	方正证券 吴文吉 兴业基金 廖欢欢 中海基金 王泉勇 兴全基金 任相栋 兴全基金 陈泓志
<b>时间</b>	2020年10月30日
<b>地点</b>	线上会议
<b>接待人员</b>	董事长潘连胜先生、董事会秘书袁欣女士
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>一. 公司情况及三季报情况简介</p> <p>神工股份由公司董事长、总经理潘连胜博士发起创立。潘博士曾就职于日本半导体硅片公司，先后从事于半导体大硅片技术研发、产品评价及市场开拓工作。潘博士回国后，选择当时国际上因技术难度大、制造商较少而需求缺口较大的大口径半导体单晶硅材料市场，于2013年在辽宁省锦州市设立公司。公司成立后凭借潘博士长年累积的技术经验及严苛的日本品质管理，很快就赢得了国际认可。目前公司海外客户都是知名的半导体大厂，同时这些海外客户也是半导体设备厂商如美国 LAM、日本 TEL 认定的合格的半导体硅电极制造商。公司是少数能打进国际半导体设备核心耗材产业链的中国公司。</p> <p>2019年公司大口径半导体单晶硅材料市占率达到13-15%，公司产能位居世界前列。公司在占领国际市场后，考虑在境内市场开拓，因此在2015年设立全资子公司福建精工半导体有限公司，精工半导体是将公司的半导体材料加工成如中</p>

芯国际、合肥长基这样的晶圆厂可以直接使用的硅电极完成品。同时，公司也很关注和支持国内的刻蚀机生产商如上海中微、北方华创的发展，公司从 2018 年起就积极与上海中微接洽，配合他们的研发提供硅电极产品，今年也启动了与北方华创的研发合作。截至目前公司是国内唯一一家从晶体材料做到硅电极完成品的中国公司。在今年国际贸易摩擦的大背景下，公司因完善的产品结构受到很多国内晶圆厂家的青睐。除了大口径的单晶硅及硅电极材料外，公司自 2016 年起开始了 8 英寸半导体硅片的研发工作，主要产品低缺陷硅片对标日本信越同类产品。今年年初募集资金到位后，公司加快了 8 英寸半导体硅片加工设备的采购工作，截至半年度公司已产出粗磨硅片。三季度开始进行净化厂房、动力设施、精加工设备调试等工作，为年末打通产线做最后准备。

公司第三季度的财报情况依然延续了第二季度起逐渐上涨的情况，所以第三季度单季度销售额环比第二季度上涨较多。根据对于后期市场整体趋势判断，公司认为上涨趋势应该还会延续。公司库存因为在 2019 年有一定的交付下滑，同时 2020 年初受疫情影响，整体需求减缓，所以公司的库存在年初时比较高，现在随着销售情况的不断好转，第三季度起库存也有较快的下降。在今年年末，还将按照最初的经营目标，争取全年的销售收入和去年持平。

## **二. Q3 同比增长较大预计后面也会有显著增幅，Q3 大幅增长的背后逻辑及后续持续性？**

第三季度的增长原因主要有几个，第一个是市场回暖。2019 年行业景气度下降，公司收入从高位逐步走低，2020 年行业景气度回暖，公司收入从低位逐步走高。第二个因素是疫情，行业库存在 2019 年年底及今年一二季度逐渐消化，但一、二季度公司收入没有增长很快是因为受到疫情影响。第三个原因是国外也逐渐适应了疫情的状况，虽然生活上有一些不方便，但是生产部门尤其是日本、韩国这些地方没有受到特别大的影响，所以三季度整体的恢复比较大。第四个原因是最近 5G、IoT 人工智能大背景的影响，驱动力比较明显，从第三季度开始就有比较大幅的增加，相当于恢复到了去年的第一、二季度的水平。

## **三. 后面 Q4 或明年 Q1 展望，材料所处周期展望？**

据客户预测，四季度已经较为确定，出货要提前生产，四季度会持续景气。明年一季度客户给了预测，也较乐观，尤其日本客户较强劲，他们说明年应该一季度也差不多，可持续三个季度，从周期性讲正常，所以明年的驱动力还在于 5G 需求，其他国外的厂商因英特尔、三星等陆续解禁，以前严峻的局面有所缓和，但是还是有比较大的不确定性。总的来说明年情况审慎乐观。

#### **四. 硅电极规划、产能情况？大概什么时候产生利润贡献？**

公司于 2015 年成立了福建精工生产硅电极完成品，因当时国内刻蚀机厂家处于发展期，同时国内整体市场需求不旺盛，公司对硅电极完成品未进行较大投入。2019 年开始，中微公司及北方华创的多种机型陆续开始在晶圆厂进行验厂，取得晶圆厂较好评价，据此公司也增加投入。今年 5 月份起公司加大了对国内晶圆厂如中芯国际、长鑫存储等的市场推广力度，相关晶圆厂对公司的技术优势表示认可。

根据公司硅电极相关销售计划，目前处于向客户送样评价阶段，时间在 6 个月左右。后续公司会配合客户工艺进行调整，预期明年开始形成销售收入，在 2022 年年中开始实现规模化销售。

#### **五. 现有业务中硅电极材料能否提升份额、市场空间？**

硅电极材料公司市占率较高，目前公司单一产能世界最大，每月约 45 吨。未来随着半导体行业整体销售稳定的稳步上涨，硅电极材料作为必要耗材空间也会随着扩大。同时，如未来世界贸易摩擦得到缓和，公司也会积极开拓美国市场，对公司市占率的提升也将有较大的帮助。

#### **六. 8 寸硅片，投片结构、产能和产能规划？**

公司 8 英寸硅片主要对标日本信越化学低缺陷硅片，是运用在高端集成电路制造商中的一个核心材料。因产品品质要求高，不仅对晶体内在原生缺陷数量控制要求高，对硅片表面缺陷数量控制也要求也很高，所以在各个加工工序都需要长时间进行技术累积，才能保障符合规模化生产的要求。公司延续日式的经营管理理念，稳扎稳打，初始投产规模 5 万片/月，与公司市场拓展需求相一致。预

	<p>计 2021 年第一季度 5 万片产能满产，经过大概半年左右时间累计出片数据送客户进行评价。</p> <p>随着评价完成，公司在 2021 年将继续采购新机台，将 5 万片产能逐步提高，依据客户需求与评价进展，逐步于 2022 年达到月产 15 万片产能。</p> <p><b>七. 8 寸设备国内已经很成熟，公司是否用的国产设备？</b></p> <p>根据公司近期参加国内半导体设备交流会获知的情况，国产 8 英寸硅片加工设备与国际上还有一定差距。因为公司第一条生产线需要对标国际大厂最高标准硅片，所以公司将采用与国际大厂相同的设备。</p> <p><b>八. 公司后续会做 12 英寸硅片么？</b></p> <p>公司募投项目研发中心建设项目，包含 12 英寸硅片晶体研发及硅片加工技术研发。20 年前潘博士在日本已做过 12 英寸的研发、量产等工作，具有足够的知识储备。基于公司稳扎稳打的企业文化，公司选择从 8 英寸做起，再向 12 英寸延伸。目前国内能做 8 英寸高端硅片的人才稀少，12 英寸更少。公司从 8 英寸开始做起，逐步培养国内人才尤其是年轻人才，为做 12 英寸打好基础提供支撑。</p> <p><b>九. 重掺片与轻掺片的区别，未来公司着重于重掺还是轻重掺？</b></p> <p>重掺片与轻掺片工艺不同，重掺片需在重掺晶体材料制成的衬底片上生长一层几十微米到一百多微米的外延层。因为有外延层，所以重掺晶体对缺陷要求较低。而轻掺片没有外延层，对轻掺晶体原生缺陷要求很高。二者技术路线不同。目前从市场份额上看，轻掺片占整个市场的 70-80%。公司主要以轻掺为主，产品对比目标是日本信越的高端硅片。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	二〇二〇年十月三十日